

Samsung anuncia sus planes de desarrollo de su proceso litográfico de 1.4 nm

Samsung está inmersa en la producción en masa de chips a 3 nm, pero de manera bastante limitada. Su itinerario de desarrollo de nuevos procesos litográficos abarca hasta finales de década, y el siguiente proceso del que ha querido hablar es del de 1.4 nm.

Según la compañía, estará listo para fabricación en masa en 2027. Será un par de años después de que Intel tenga listo su proceso de 1.8 nm, mientras que TSMC no ha hablado tan a futuro de sus procesos litográficos, solo del de 2 nm que debería estar listo para 2024.



La compañía surcoreana ha comentado que su proceso de 2 nm estará listo para producción en masa en 2025, acompañado de nuevas innovaciones en el apartado que nunca se debe perder de vista como es el del encapsulado de los chips. El sistema X-Cube con microcontactos estará listo para producción en 2024, mientras que un sistema X-Cube de encapsulado sin contactos

estará listo para 2026. Es un sistema de apilamiento de chips en un mismo empaquetado, mejorando la oferta de módulos multichip de la compañía.

El futuro cercano estará dominado por la producción de chips para los sectores de la computación de alto rendimiento, automóvil y 5G, que serán más del cincuenta por ciento de la producción de Samsung para 2027. Eso hace que la compañía esté también trabajando en otros procesos fiables para la automoción, como uno de 14 nm eNVM (memoria no volátil embebida) que estará listo para 2024, y otro de 8 nm eNVM. Para las comunicaciones, tiene en producción un proceso específico de 8 nm para radiofrecuencia, y tiene en desarrollo uno de 5 nm.

Por último, la compañía ha indicado que espera tener el triple de producción en 2027 de nodos avanzados que la que tiene ahora mismo. Eso va a precisar una continua expansión de su producción, empezando por la que tiene en construcción en Taylor (Tejas), que se sumará a las dos que ya tiene en EUA y las tres de Corea del Sur.

Fuente: TechPowerUp.